

JP Kokai Publication Sho-49-102726

1. A method of adhesion treatment comprising steps of attaching an adhesive bonding layer or a bonding layer to an object and pressure-solidifying the layer,

wherein said adhesive bonding layer is formed by applying polymer or material mixing polymer and flattened-particle pigments by electrodeposition on the electroconductive surface, and insufficient state, and

said bonding layer is formed by applying a usual adhesive agent on the adhesive bonding layer.

2. A method of adhesion treatment comprising steps of attaching an adhesive bonding layer or a bonding layer to an object and pressure-solidifying the layer,

wherein said adhesive bonding layer is formed by applying polymer or material mixing polymer and electronic material particles by electrodeposition on the electroconductive surface, and insufficient state; said electronic material particles being conductor, semiconductor, magnetic substance, or ferroelectrics,

said bonding layer is formed by applying a usual adhesive agent on the adhesive bonding layer, and

said object is piezoelectric element, semiconductor element or magnetic element.



特許庁長官 殿

特許法第8条ただし書の規定による特許出願

昭和48年11月27日

① 日本国特許庁  
公開特許公報

① 特開昭 49-102726

④ 公開日 昭49.(1974) 9 27

② 特願昭 48-11724

② 出願日 昭48.(1973) / .29

審査請求 有 (全3頁)

庁内整理番号

⑤ 日本分類

6660 48

24(A)A03

6683.37

24(D)D01

1 発明の名称 電圧による積層層の形成方法

2 特許請求の範囲に記載された発明 3

3 発明者 出願人と同じ

4 特許出願人

住所 2777-2222 川崎市高津区宮崎1丁目1番地5

氏名 伊藤 孝 代表者

5 特許書類の目録

(1) 願書原本

(2) 明細書

(3) 出願書並請求書

(4) 図面



明 細 書

方法。

1 発明の名称

電圧による積層層の形成方法

2 特許請求の範囲

1. 導電性表面に高分子またはそれに類する粒子状の原料を堆積した材料を電圧作用によって処理させた未形成状態の絶縁層に、あるいはさらにその上に通常の積層剤を塗布してなる積層層に、所定の積層体を密着させたのち前記積層層を圧着固化させる積層処理の方法。
2. 導電性表面に高分子またはそれに類する導体、半導体、絶縁体あるいは積層電体のとき電子材料、粒子を堆積した材料を電圧作用によって処理させた未形成状態の絶縁層に、あるいはさらに通常の積層剤を塗布してなる積層層に、圧電素子、半導体素子および積層素子のとき所定の積層体を密着させ、しかも前記積層層を圧着固化させる積層処理の方法。

3 発明の要旨を説明

一般に金属側面あるいは極めて小さな部品間の金属片を他の被接合物質の表面に接合するには、真空炉内等で作られた通常の積層剤を被接合物質に何らかの方法にて直接塗布し乾燥させて両者の接合をなすしめる。しかし被接合物のものと金属側面との接合性は良くとも金属片に対する接合効果は通常をわけて早く、また安定性に劣る。殊に少量の積層剤しか使えないような場合には適切な接合性を得ることが困難である。本発明の方法は金属その他の導電性表面において電圧作用をとらえて高分子等を塗布させる。特許請求の範囲によって、塗布した箇所あるいはこれに原料を配合したものが極めて狭密かつ狭間に金属表面に対して被着させることができるので、これを接合介在層（または中間層）として利用したものである。

すなわち被接合層を間接とし、他の側の被接



以上に示した実施例からもわかるように本発明の方法は、極めて広い有用図がある。そして結合材料の中に図1に示す、導体、半導体あるいは誘電体のごとき電子材料としての機能をもつ物質の微粒子を、電場熱伝導法中に温度を上げて電離することにより、その電気的性質を付与した集合体を形成することができる。

例えば上に述べた実施例のほかヒモロゲン、微粒子の電気的性質と金属体の機械的性質とを相違よく変換するためのトランジスタあるいは極端かつ小型の回路回路の結合部などには極めて効果的な手段となり堅固性にも寄与方法である。

#### 4 図面の簡単な説明

第1図人は金属体表面に半導体薄膜を形成した上面図であり、第1図Bはその側面図を例示したものである。

そして第2図は図1AのY-Yの線に沿った断面図である。

特許出願人 〇 〇 〇

特開 昭49-102726 (B)

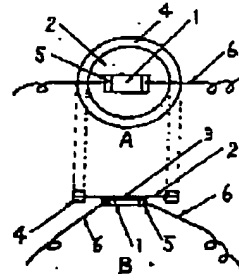


図 1

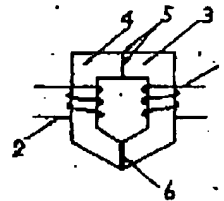


図 2